

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XCM526xxxxDR-G
標準質量: 9 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.167	シリコン	129700	7440-21-3
	0.033	金	3700	7440-57-5
リードパッド	2.248	ニッケル	249800	7440-02-0
	0.178	銀	19800	7440-22-4
	0.033	金	3600	7440-57-5
ダイアタッチ	0.040	銀	4500	7440-22-4
	0.007	エポキシ樹脂	700	—
ボンディングワイヤ	0.170	金	18900	7440-57-5
封止樹脂	4.611	溶融シリカ	512300	60676-86-0
	0.282	エポキシ樹脂	31300	—
	0.231	フェノール樹脂	25600	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。